

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年7月27日(27.07.2023)



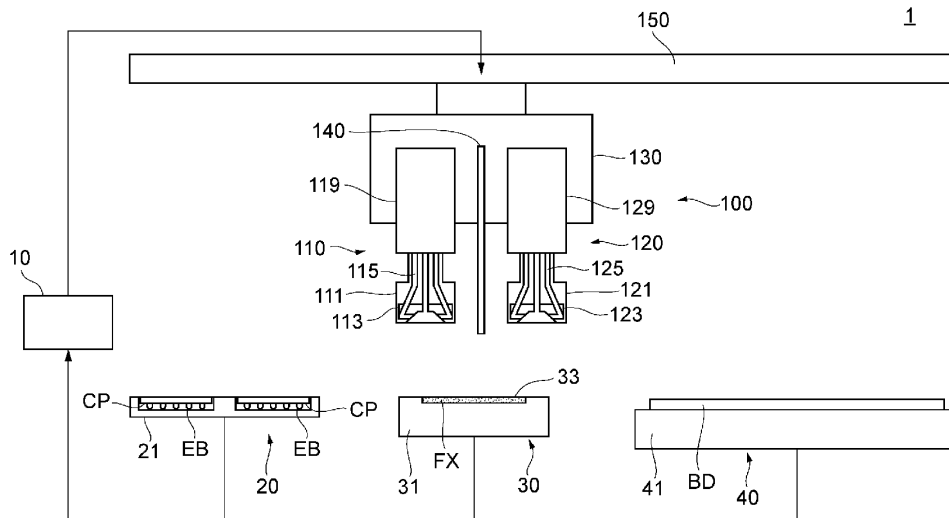
(10) 国際公開番号

WO 2023/139685 A1

- (51) 国際特許分類:
H05K 3/34 (2006.01) **H05K 13/04** (2006.01) 都 武 蔵 村 山 市 伊 奈 平 2 丁 目 5 1 番 地 の
1 株式会社新川内 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/001776 (74) 代理人: 稲葉 良幸, 外(INABA, Yoshiyuki et al.);
〒1066123 東京都港区六本木 6 - 1 0 -
1 六本木ヒルズ森タワー 2 3 階 T M I
総合法律事務所 Tokyo (JP).
- (22) 国際出願日: 2022年1月19日(19.01.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人: 株式会社新川(SHINKAWA LTD.) [JP/
JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2
丁目 5 1 番地の 1 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 吉 田 信 一 (YOSHIDA, Shinichi);
〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目
5 1 番地の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP).
瀬山 耕平(SEYAMA, Kohei); 〒2088585 東京
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,

(54) Title: ELECTRONIC COMPONENT MOUNTING DEVICE AND ELECTRONIC COMPONENT MOUNTING METHOD

(54) 発明の名称: 電子部品実装装置及び電子部品実装方法



(57) Abstract: An electronic component mounting device (1) comprises: an electronic component supply unit (20) that supplies an electronic component having a bump electrode (EB); a transfer stage (31) that accumulates a flux (FX); a mounting stage (41) on which a substrate (BD) is placed; a plurality of heads that can each pick up an electronic component (CP); and a control unit (10) that controls movement of the plurality of heads. The control unit (10) is configured so as to cause each of the plurality of heads to function as a dipping head that dips the bump electrode (EB) of the electronic component (CP) into the flux (FX) accumulated on the transfer stage (31), or as a bonding head that mounts the electronic component (CP) to the substrate (BD) on the mounting stage (41) with the bump electrode (EB) interposed therebetween.

[続葉有]

NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 電子部品実装装置 (1) は、バンプ電極 (E B) を有する電子部品 (C P) を供給する電子部品供給部 (2 0) と、フラックス (F X) を貯留する転写ステージ (3 1) と、基板 (B D) が載置される実装ステージ (4 1) と、電子部品 (C P) をピックアップ可能である複数のヘッドと、複数のヘッドの動作を制御する制御部 (1 0) とを備え、制御部 (1 0) は、複数のヘッドを、電子部品 (C P) のバンプ電極 (E B) を転写ステージ (3 1) に貯留されたフラックス (F X) に浸漬させるディッピングヘッドと、実装ステージ (4 1) の上の基板 (B D) に対してバンプ電極 (E B) を介して電子部品 (C P) を実装させるボンディングヘッドと、に分担して機能させるように構成される。